

英特尔最新人事变动,藏着什么大招?

本报记者 姬晓婷

昨天,英特尔公布了两项人事变动:任命 Alex Katouzian 为执行副总裁兼客户端计算与物理 AI 事业部 (Client Computing & Physical AI Group) 总经理; Pushkar Ranade 为首席技术官。当天,英特尔股价应声大涨 12.92%。

关于这两项任命的目的,英特尔的官方新闻稿中只有“旨在加强核心产品业务并推进公司创新进程”一句话。但其背后透露出的企业布局,却远远不只表面看起来那么简单。



Alex Katouzian

Pushkar Ranade

英特尔近期开始强调融合路线,期待 Katouzian 给公司的跨平台整合能力带来新可能。

备战跨平台整合?

英特尔的这两项人事任命有很多值得解读的信息,首先便是被任命为执行副总裁兼客户端计算与物理 AI 事业部总经理的 Alex Katouzian 的身份。

Katouzian 此前任职于高通公司,担任执行副总裁兼手机、计算和 XR 事业部总经理。据悉,将手机、PC、XR、汽车、物联网“融合”为统一计算平台正是他核心的技术主张。

押注物理 AI?

与英特尔任命 Katouzian 同时发生的,还有英特尔事业部的更名。根据英特尔于 4 月 23 日发布的 2026 年第一季度财报,其最大的业务板块仍为客户端事业部 (Client Computing Group),而 5 月 5 日公布的任命中, Alex Katouzian 成为执行副总裁兼客户端计算与物理 AI 事业部 (Client

今年 3 月,《中国电子报》记者在 MWC 2026 现场采访了 Alex Katouzian。当时, Katouzian 透露出的核心观点是:个人 AI 正在脱离单一硬件的束缚,演变为一种“随人而动”的分布式能力,即用户需要的只是一台帮自己做事的机器,至于这台设备的外形是怎样的,用户并不关心。

智能体的出现无疑是 Katouzian 一直倡导的链接、计算和 AI 深

度融合的应用形态。从芯片供应商的角度来看,只要芯片供应商的能力能够覆盖足够丰富的终端设备,且实现各设备之间的流畅链接,那么该芯片厂商的生意就能越做越大。

今年,英特尔也开始强调融合路线。在 4 月 21 日英特尔组织的一场以“混合 AI 部署”为主题的分享会上,英特尔就十分强调其在推动 AI 智能体普及方面的能力。其中,最大

的亮点,在于它给 AI 任务分层,在电脑端加入了一个“任务路由”的卡口,使能在本地计算的任务尽量在本地完成,从而降低云资源消耗,帮助用户降低 token 使用成本。

当然,在英特尔,这一技术路线仍然是由 PC 团队主导的,本质上还是 PC 的升级。

或许,英特尔会期待 Katouzian 给英特尔的跨平台整合能力带来新的可能。

英特尔要强化 x86 架构在物理 AI 领域的优势地位,这将是 Katouzian 面临的重要课题。

期间, Arm 与高通联手推出了机器人组合“全家桶”,赋能从家用机器人到全尺寸人形机器人的物理 AI,更不用说已经拥有相当用户基础的英伟达。面对当前的竞争形势,英特尔要做的便是强化 x86 架构在物理 AI 领域的优势地位,这恐怕也是 Katouzian 将面临的重要课题。

型赋能等能力。由于英特尔面向机器人的业务是基于其消费端酷睿 Ultra 处理器部署的,这也解释了物理 AI 业务出现在客户端事业部的原因。

以机器人为代表的物理 AI 市场仍处于快速增长阶段,选什么芯片作为机器人开发的平台底座,是机器人厂商正面临的问题。今年 CES

期间, Arm 与高通联手推出了机器人组合“全家桶”,赋能从家用机器人到全尺寸人形机器人的物理 AI,更不用说已经拥有相当用户基础的英伟达。面对当前的竞争形势,英特尔要做的便是强化 x86 架构在物理 AI 领域的优势地位,这恐怕也是 Katouzian 将面临的重要课题。

型赋能等能力。由于英特尔面向机器人的业务是基于其消费端酷睿 Ultra 处理器部署的,这也解释了物理 AI 业务出现在客户端事业部的原因。

以机器人为代表的物理 AI 市场仍处于快速增长阶段,选什么芯片作为机器人开发的平台底座,是机器人厂商正面临的问题。今年 CES

期间, Arm 与高通联手推出了机器人组合“全家桶”,赋能从家用机器人到全尺寸人形机器人的物理 AI,更不用说已经拥有相当用户基础的英伟达。面对当前的竞争形势,英特尔要做的便是强化 x86 架构在物理 AI 领域的优势地位,这恐怕也是 Katouzian 将面临的重要课题。

型赋能等能力。由于英特尔面向机器人的业务是基于其消费端酷睿 Ultra 处理器部署的,这也解释了物理 AI 业务出现在客户端事业部的原因。

以机器人为代表的物理 AI 市场仍处于快速增长阶段,选什么芯片作为机器人开发的平台底座,是机器人厂商正面临的问题。今年 CES

期间, Arm 与高通联手推出了机器人组合“全家桶”,赋能从家用机器人到全尺寸人形机器人的物理 AI,更不用说已经拥有相当用户基础的英伟达。面对当前的竞争形势,英特尔要做的便是强化 x86 架构在物理 AI 领域的优势地位,这恐怕也是 Katouzian 将面临的重要课题。

型赋能等能力。由于英特尔面向机器人的业务是基于其消费端酷睿 Ultra 处理器部署的,这也解释了物理 AI 业务出现在客户端事业部的原因。

以机器人为代表的物理 AI 市场仍处于快速增长阶段,选什么芯片作为机器人开发的平台底座,是机器人厂商正面临的问题。今年 CES

期间, Arm 与高通联手推出了机器人组合“全家桶”,赋能从家用机器人到全尺寸人形机器人的物理 AI,更不用说已经拥有相当用户基础的英伟达。面对当前的竞争形势,英特尔要做的便是强化 x86 架构在物理 AI 领域的优势地位,这恐怕也是 Katouzian 将面临的重要课题。

型赋能等能力。由于英特尔面向机器人的业务是基于其消费端酷睿 Ultra 处理器部署的,这也解释了物理 AI 业务出现在客户端事业部的原因。

以机器人为代表的物理 AI 市场仍处于快速增长阶段,选什么芯片作为机器人开发的平台底座,是机器人厂商正面临的问题。今年 CES

2026年Q1全球半导体销售创季度营收历史新高

本报讯 近日,美国半导体行业协会(SIA)公布最新数据,2026年第一季度全球半导体销售额达到2985亿美元,环比大涨25%,创下季度营收历史新高;3月单月销售额更是高达995亿美元,同比暴增79.2%,行业迎来AI驱动的超级增长周期。

本次统计覆盖逻辑、存储、模拟、混合信号等全品类芯片,数据由世界半导体贸易统计组织(WSTS)以3个月滚动均值核算。SIA代表美国99%营收规模的芯片企业,同时覆盖全球近2/3境外芯片厂商,这意味着全球实际半导体销售额已突破3000亿美元大关。

区域市场全线爆发,3月同比增速方面,亚太地区同比增长108.5%,美洲增长83.1%,中国增长74.8%,欧洲增长46.5%,日本增长7.4%;环比同样全面上涨,中国、美洲市场增幅均超12%,需求旺盛态势席卷全球。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 明确表示,当前增长势头强劲,2026年全球半导体销售额有望首次突破1万亿美元,完成行业历史性跨越。本轮爆发核心驱动力来自 AI 算力需求,数据中心对 HBM、高端逻辑芯片需求激增,带动存储、晶圆代工等环节量价齐升。

(文 轩)

华邦电子2026年第一季度营收同比涨91.3%

本报讯 近日,华邦电子在法说会上表示,公司2026年第一季度营收约83亿元,环比增长43.7%、同比大涨91.3%;毛利率飙升至53.4%,环比增加11个百分点,同比增加27个百分点;税后净利润约22亿元,环比暴增226.9%,同比由亏转盈;归母净利润新台币101.14亿元,环比暴增195.5%,同比扭亏为盈。

华邦电子今年第一季度业绩的爆发式增长,核心驱动力来自 DRAM 与 NAND 两大产品线的同步量价齐升。

在定制化内存(CMS/DRAM)业务方面,华邦电子第一季度 CMS 营收环比大涨93%,同比暴增276%,营收占比升至47%,出货位元环比增长约25%。主要动能来自于 DDR4 与 LPDDR4 出货量的大幅成长,产品的平均售价(ASP)环比增长超50%,同比增幅更是翻倍。

华邦电子总经理陈沛铭强调,DDR4 与 LPDDR4 面临的是“结构性供给缺口”,因全球内存大厂的新增投资全面转向 HBM、11/12nm 的

DDR5、LPDDR5 等先进产品,不会再回头扩充 DDR4、LPDDR4 产能,导致了传统的 DDR4 与 LPDDR4 的供应紧缺,这一缺口预计将持续至 2028 年以后,短期内供给改善空间极为有限。

在 NAND 业务方面,华邦电子第一季度营收环比增长23%、同比大涨89%,营收占比32%,ASP 环比增长约34%至36%、同比增幅60%以上。NOR Flash 与 SLC NAND 需求旺盛,高容量产品线整体出货占比持续提升。华邦电子预计,自第二季度起,24nm SLC NAND 将逐步带来显著营收贡献。

从应用端来看,消费电子受 AI 服务器、数据中心与基础设施需求拉动,环比增长幅度最大,达到了74%,在总营收当中的占比达27%。其他市场的需求也全面回暖,车用与工业应用营收环比大涨66%,占比30%;消费电子营收环比增长13%,占比13%。

(宣 文)

安森美预计今年 AI 数据中心营收翻倍

本报讯 安森美半导体近日公布了 2026 财年第一季度财报,财报显示,安森美 2026 年第一季度实现营收 15.13 亿美元,同比增长 5%。

从具体的业务部门表现来看,安森美功率解决方案(PSG)第一季度营收 7.4 亿美元,模拟与混合讯号(AMG)为 5.4 亿美元,智慧传感(ISG)则为 2.4 亿美元。

从具体的终端应用市场来看,第一季度安森美的数据中心业务表现最为突出。安森美 CEO Hassan El-Khoury 透露,公司 AI 数据中心营收环比增长超过 30%,同比实现翻倍以上增长。

随着 AI 大模型训练和推理对算力需求的持续攀升,机架功率密度从当前的 120 千瓦向 600 千瓦甚至 1 兆瓦演进,对高效电源管理半导体的需求正急剧膨胀。安森美是

全球少数能够覆盖从低压到 800V 高压完整“功率树”的芯片供应商,其碳化硅 MOSFET、JFET 及垂直氮化镓技术在新一轮 AI 基础设施建设中占据了有利位置。

安森美管理层还在业绩电话会上透露,公司 2025 年 AI 数据中心营收约为 2.5 亿美元,预计 2026 年全年将再次实现同比翻倍,达到约 5 亿美元。

安森美表示,到 2029 年,AI 数据中心相关的总市场规模将达 122 亿美元,年复合增长率约 40%。

展望未来,安森美预计第二季度营收区间为 15.35 亿至 16.35 亿美元。从更长远的视角看,安森美管理层重申了雄心勃勃的战略目标:营收年复合增长率 10%~12%,毛利率达到 53%,营业利润率升至 40%。

(许子皓)

强化 CPU 价值?

英特尔 5 月 5 日的另一项人事任命则展现出其对未来的规划:出任首席技术官的 Pushkar Ranade 主导专项技术项目,并推动量子计算、神经拟态计算、光子学及新型材料等关键新兴领域的发展。在硅谷,在科技投资界,这一调整可能更符合市场预期:这意味着英特尔要筑牢技术护城河,保证英特尔在硅光、量子等新兴领域不掉队,甚至处于领先地位。

截至美东时间 5 月 5 日 16:00,英特尔股价 108.15 美元/股,是 3 月 31 日股价的 2.45 倍,是去年低谷期的 5.5 倍。

2025 年 3 月,现任首席执行官陈立武在英特尔的低谷期临危受命,他接手的英特尔正面临业界两大质疑:代工业务持续亏损,在 AI 方面的反应过于迟缓。

2025 年 4 月 1 日,在 Intel Vision 大会上,首次发表公开演讲的陈立武做出了几方面调整承诺,包括:招募业内最优秀的人才加入或重新加入英特尔,改进用于 AI 推理的 CPU,加强数据中心产品线,以及将英特尔代工打造成一个“伟大的代工厂”。现在看来,履职一年的陈立武正在逐渐兑现承诺。

4 月 23 日,英特尔发布财报,企

业整体利润达到 17 亿美元,同比增长 142.9%; DCAI (数据中心 AI) 事业群利润达 15 亿美元,同比增长 150%,其在英特尔整体营收中的比重从上年同期的 32.3% 升至 37.5%。

在过去几个月中,英特尔就回购其位于爱尔兰的英特尔 Fab 34 工厂 49% 股权达成协议;在 Intel4 和 Intel3 方面取得稳步进展,18A 良率超出内部预期;推出工作站处理器至强 600 和锐炫 Pro B70 专业级显卡,直击市场对于端侧部署智能体的呼吁。

不仅如此, AI 技术发展对基础设施的依赖,也让越来越多的人认

AI 技术发展对基础设施的依赖,也让越来越多的人认可“CPU 价值回归”的市场逻辑。

可“CPU 价值回归”的市场逻辑。此前,英特尔公司执行副总裁兼数据中心事业部(DCG)总经理 Kevin Kechichian 表示:“我们看到 CPU 与 GPU 的使用比例正在翻倍甚至三倍增长,我预测最终会接近 1:1。”而在智能体兴起之前,典型的数据中心中 CPU 与 GPU 的比例是 1:4 甚至 1:8。

当然, AI 仍在以所有人无法估量的速度进化,相关公司的市值和营收也在随着新事件的出现起起伏伏,今时聚光灯下的新锐可能一夜之间失去光彩,昔日的王者也可能随时回归。

算力需求“光”芒四射

(上接第 1 版)

同时,光模块产品迭代速度显著加快。目前,800G 光模块已成为 AI 数据中心的主流配置,1.6T 光模块进入大规模商用前夜,3.2T 光模块研发进度也超出预期。数据显示,2026 年全球 800G 和 1.6T 高速光模块市场规模合计将达 146 亿美元,占整体光模块市场约 64%。未来三年,800G、1.6T 等高速光模块的需求将进一步占据市场主导地位,3.2T 光模块则有望从 2028 年起逐步放量。

在这次光通信热潮中,中国企业表现亮眼。从企业营收看,在全球光模块厂商 TOP10 榜单中,中国企业占据五席,其中,中际旭创以 33

亿美元的营收、同比 114% 的营收增长率和超 40% 的 800G 光模块市场占有率位列全球第一。行业专家告诉记者:“在 AI 驱动下,光通信板块进入高景气周期,光通信全球供应链链移向亚洲是大势所趋。”

“中国之光”空间巨大

AI 如何成为“撬动”光通信行业的“杠杆”?这要从 AI 大模型的发展需求和端侧硬件演进说起。当前 ChatGPT 类大模型训练一次需要传输超 1000PB 数据,这就对数据中心中的 AI 服务器带宽提出了新的要求,需要使用能以接近光速传输数据的光模块来连接 ToR (Top of

Rack) 交换机,实现高带宽、低延迟的通信。

在 AI 集群中,传统数据中心 1 颗 GPU 需要配 3 个光模块,现在 Meta 架构达到 1:8,英伟达 GB200 集群更是达到 1:12。随着光配比率的上升,算力基础设施对光模块的需求正呈几何级数增长。

除了模型的训练需求外,智能体的普及应用也是反向驱动算力基础设施建设需求的重要引擎。国家数据局发布的数据显示,截至 2026 年 3 月,我国日均词元(Token)调用量已超过 140 万亿,相比 2024 年年初的 1000 亿增长了 1000 多倍。如此庞大的词元调用量,需要数据中心在背后提供算力支撑,这也进一

步驱动了对光模块的需求量。

在庞大的需求下,产业对光模块的性能提出了越来越高的要求,光模块技术迭代速度极快。行业研究机构 Frost & Sullivan 数据显示,800G 光模块 2020—2024 年年复合增长率约为 188%,1.6T 光模块 2024—2029 年年复合增长率高达 180%。当前,头部企业的 1.6T CPO 引擎技术已实现量产,效率上的多重突破:2026 年第一季度,中际旭创 1.6T 光模块出货约 45 万只,全球市占率高达 55%~60%;新易盛自研硅光芯片良率达到 95%,成本降低 30%。高盛研报预计,2026 年全球 800G 光模块出货量较 2025 年翻倍,1.6T 光模块的出货量将从百万支级

别跃升至逾 2000 万支。

同时, AI 算力浪潮正在带动光通信全产业链爆发式增长,尤其是产业链上游的光芯片、光器件领域。作为 800G、1.6T 高速光模块的核心组件,EML 光芯片正面临巨大的产能缺口:2026 年全球 EML 光芯片需求将达到 3.5 亿颗,但产能只有 2 亿颗左右,缺口高达 1.5 亿颗。全球光芯片龙头 Lumentum 首席执行官 Michael Hurlston 公开表示:“仅靠两个季度,我们就能将整个 2028 年的产能全部售罄。”

当前,光芯片领域的高端产能仍大多被海外企业垄断,高端 EML 芯片的国产化率只有 4% 左右,但这同时也意味着巨大的发展空间。记

者了解到,在 EML 芯片的原材料磷化铟衬底领域,云南锗业已经实现 6 英寸衬底量产,长光华芯也增资苏州沅光切入磷化铟赛道;从芯片成品看,源杰科技成为国内首家实现 100G EML 芯片规模化量产的公司,良率稳定在 70% 以上;光迅科技作为国内唯一“芯片-器件-模块”全产业链 IDM 龙头,其 1.6T 硅光良率可达 95% 以上,本土化发展正在加速。

站在这一技术变革与市场需求爆发的交汇点,专家指出,未来,中国光通信企业应充分发挥自身优势,加大技术创新力度,加快国产化步伐,力争在全球光通信产业竞争中占据更加有利的位置。